

证券代码：002957

证券简称：科瑞技术



深圳科瑞技术股份有限公司

Shenzhen Colibri Technologies Co., Ltd.

（广东省深圳市光明区玉塘街道田寮社区光侨路科瑞智造产业园

瑞明大厦 A 塔 20 层）

2026 年度向特定对象发行股票预案

二〇二六年九月

公司声明

1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对预案的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

2、本预案按照《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等要求编制。

3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。

4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或者其他专业顾问。

6、本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需获得公司股东会的审议批准并经深圳证券交易所审核通过、中国证监会作出同意注册的批复。中国证监会、深圳证券交易所等监管部门对本次发行所作出的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益作出实质性判断或保证。

重要提示

一、本次向特定对象发行股票相关事项已经公司第五届董事会第七次会议通过。本次发行股票方案尚需公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册批复后方可实施。

二、公司本次向特定对象发行股票的发行对象不超过 35 名（含本数），为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者、自然人或其他合格投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、理财公司、保险公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

最终发行对象由董事会根据股东会授权在本次发行经深交所审核通过并获得中国证监会同意注册的批复后，遵照届时确定的定价原则，与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。若国家法律、法规对向特定对象发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。

本次发行对象均以现金的方式并以相同的价格认购本次发行的股票。

三、本次发行募集资金总额不超过 75,248.41 万元（含本数），在扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	超高精密度零部件基地建设及相关设备扩产项目	69,729.39	63,248.41
2	补充流动资金	12,000.00	12,000.00
合计		81,729.39	75,248.41

本次发行募集资金到位之前，公司可根据项目实际进展情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后，以募集资金置换自筹资金。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、顺序及各项目的具体投

资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

四、本次发行定价基准日为公司本次发行股票的发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。在本次发行的定价基准日至发行日期间，如公司实施现金分红、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则将根据深圳证券交易所的相关规定对发行价格作相应调整。

五、本次发行股票数量不超过 125,994,739 股（含本数），不超过本次发行前公司总股本的 30%，最终发行数量由公司股东会授权董事会在本次发行取得中国证监会作出予以注册的决定后，根据法律、法规和规范性文件的相关规定及发行时的实际情况，与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的，则本次发行的股票数量上限将进行相应调整。

六、本次向特定对象发行的股票，自本次发行结束之日起 6 个月内不得转让。本次发行结束后，由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期届满后发行对象减持认购的本次发行的股票须遵守中国证监会、深交所等监管部门的相关规定。

七、公司一贯重视对投资者的持续回报。根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关要求，公司制定了利润分配政策、分红回报规划等，详见本预案“第四节 公司利润分配政策及执行情况”。

八、根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的有关规定，公司制定了本次发行股票后填补被摊薄即期回报的措施，公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，相关措施及承诺请参见本预案“第五节 与本次发行相关的董事

会声明及承诺事项”之“二、本次发行对摊薄即期回报的影响及填补回报的具体措施”。同时，公司特别提醒投资者制定填补回报措施不等于对公司未来利润作出保证。

九、本次发行前的滚存未分配利润，由本次向特定对象发行完成后的新老股东按照发行后的股份比例共享。

十、本次发行的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件，也不会导致本公司的控股股东和实际控制人发生变化。

十一、董事会特别提醒投资者仔细阅读本预案“第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析”之“六、本次股票发行相关的风险说明”，注意投资风险。

目 录

公司声明	1
重要提示	2
目 录	5
释 义	7
第一节 本次发行股票方案概要	8
一、发行人基本情况	8
二、本次发行的背景和目的	8
三、发行对象及其与本公司的关系	12
四、本次发行股票方案概要	12
五、本次发行是否构成关联交易	15
六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	15
七、本次发行是否可能导致公司股份分布不具备上市条件	16
八、本次向特定对象发行的审批程序	16
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	17
一、本次募集资金使用计划	17
二、募集资金投资项目情况介绍	17
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	23
一、本次发行后公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构、 业务收入结构的变动情况	23
二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流的变动情况	24
三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及 同业竞争等变化情况	25
四、本次发行完成后，公司不存在资金、资产被控股股东及其关联人占用 的情形，不存在公司为控股股东及其关联人提供担保的情形	25
五、公司负债结构合理，不存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负 债）的情况，不存在负债比例过低、财务成本不合理的情况	25
六、本次股票发行相关的风险说明	25
第四节 公司利润分配政策及执行情况	28

一、公司利润分配政策	28
二、公司最近三年的利润分配情况	31
三、未来三年股东分红回报计划（2026 年-2028 年）	31
第五节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项	32
一、董事会关于除本次发行外未来十二个月内是否有其他股权融资计划的声明	32
二、本次发行对摊薄即期回报的影响及填补回报的具体措施	32

释 义

本预案中，除非另有说明，以下词汇具有如下特定含义：

科瑞技术、公司、发行人、本公司、股份公司	指	深圳科瑞技术股份有限公司
有限公司	指	科瑞自动化技术（深圳）有限公司，发行人前身
新加坡科瑞技术	指	COLIBRI TECHNOLOGIES PTE LTD，发行人控股股东
潘利明	指	PHUA LEE MING，发行人董事长、实际控制人
实际控制人	指	PHUA LEE MING
科瑞科技	指	深圳市科瑞技术科技有限公司
本次发行	指	本公司本次在中国境内（不含中国香港、中国台湾、中国澳门地区）向特定对象发行普通股股票的行为
A 股	指	在中国境内（不含中国香港、中国台湾、中国澳门地区）发行的以人民币认购和交易的普通股股票
元、万元	指	人民币元、万元
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《深圳科瑞技术股份有限公司章程》

本预案所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标。

本预案中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，均为四舍五入所致。

第一节 本次发行股票方案概要

一、发行人基本情况

公司名称	深圳科瑞技术股份有限公司
英文名称	Shenzhen Colibri Technologies Co., Ltd.
股票简称	科瑞技术
股票代码	002957
股票上市地	深圳证券交易所
上市日期	2019 年 7 月 26 日
有限公司成立日期	2001 年 5 月 23 日
股份公司成立日期	2013 年 10 月 18 日
法定代表人	PHUA LEE MING
注册资本	41,998.2466 万元
统一社会信用代码	9144030072854000X9
注册地址	广东省深圳市光明区玉塘街道田寮社区光侨路科瑞智造产业园瑞明大厦A塔20层
联系电话	86-755-26710011-1688
传真	86-755-26710012
邮政编码	518132
互联网地址	www.colibri.com.cn
经营范围	光机电自动化相关设备的设计开发及生产经营；系统集成；计算机软件开发；企业先进制造及配套自动化方案咨询与服务；机器设备租赁业务（不含金融租赁业务）

二、本次发行的背景和目的

（一）本次发行的背景

1、国家战略与产业政策驱动，高端精密制造处于重要发展机遇期

随着全球算力产业高速扩张叠加半导体设备、光通信产业链国产替代进程持续推进，半导体与光通信领域对高性能精密零部件及配套精密设备的需求快速释放。精密零部件与精密设备作为半导体设备、光通信产品的核心上游配套环节，其加工精度、设备性能等核心特性直接决定下游整机设备的性能指标，是制约我国半导体、光通信产业链自主可控的关键基础环节。当前，国家围绕产业创新发展、算力基础设施建设等方向出台多项顶层政策，持续引导资源向

高端精密零部件及配套精密设备领域倾斜，推动关键零部件、精密设备的技术攻关、工艺迭代与产业化落地，为半导体及光通信领域精密零部件与精密设备行业发展构筑良好的政策环境。

时间	发布机构	政策名称	主要内容
2026 年 6 月	工信部	《“人工智能+信息通信”创新发展实施意见（2026—2028 年）》	部署智算网络技术产业能力提升行动，明确提出加强高速光电芯片、全光交换器件、光电共封装器件等技术和产品研发验证，开展光电混合组网技术试验，加速技术方案成熟；加强智算超节点光电互联技术攻关，开展智算网络技术与产品验证
2026 年 4 月	工信部	《关于开展普惠算力赋能中小企业发展专项行动的通知》	部署算力资源配置提升行动，深入开展城域“毫秒用算”专项行动，扩大城域 1 毫秒时延圈覆盖范围；推动光网络设备向产业园区等用户侧延伸，推动全光交换等技术应用部署，降低算力应用终端到服务器的网络时延，提升应用交互体验。
2025 年 10 月	工信部等七部门	《深入推动服务型制造创新发展实施方案（2025—2028 年）》	加强关键共性技术攻关，发布服务型制造关键共性技术清单；实施共享制造培育提升行动，建设共享制造平台和共享工厂，集中配置通用性强、购置成本高的生产设备，满足设计研发、加工制造、检验检测等共性需求；面向电子制造等行业推进服务型制造典型模式，促进服务要素融入制造业。
2025 年 9 月	工信部、国家市场监督管理总局	《电子信息制造业 2025—2026 年稳增长行动方案》	坚定不移推动“国货国用”，持续推动短板产业补链、优势产业延链；通过集成应用牵引，提升元器件、零部件等产品可靠性、安全性；强化计算等领域芯片、零部件、整机系统等研发应用和配套适配；面向光子领域重点环节开展技术攻关，加大对高速光芯片、光电共封领域的研发投入力度，推动光架构与现有电架构体系生态融合。
2025 年 9 月	工信部等六部门	《机械行业稳增长工作方案（2025—2026 年）》	支持工业母机、机器人、智能检测装备等攻关创新，提升数控机床等高端产品可靠性水平；实施基础产品可靠性“筑基”工程，持续提升丝杠、导轨、主轴、精密齿轮、精密模具等精密零部件的可靠性与一致性；加大对装备企业金融支持力度，推动优质装备企业上市融资
2024 年 3 月	国务院	《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》	实施设备更新、消费品以旧换新、回收循环利用、标准提升四大行动；聚焦长期困扰传统产业转型升级的产业基础、重大技术装备“卡脖子”难题，积极开展重大技术装备科技攻关。完善“揭榜挂帅”、“赛马”和创新产品迭代等机制，强化制造业中试能力支撑，加快创新成果产业化应用。

时间	发布机构	政策名称	主要内容
2024 年 3 月	工信部等七部门	《推动工业领域设备更新实施方案》	围绕推进新型工业化，以大规模设备更新为抓手，实施制造业技术改造升级工程；推动高端先进设备更新，针对半导体等行业，鼓励企业更新升级一批高技术、高效率、高可靠性的先进设备；推动智能制造设备更新，推广应用数控机床与基础制造装备。
2024 年 3 月	市场监管总局等 18 部门	《贯彻实施<国家标准化发展纲要>行动计划（2024—2025 年）》	健全产业基础标准体系，制修订精密减速器、高端轴承等核心基础零部件共性技术标准，推动解决产品高性能、高可靠性、长寿命等关键问题；加强标准化与科技创新互动，强化关键技术领域标准攻关，加快产业创新标准引领；
2024 年 1 月	工信部等七部门	《关于推动未来产业创新发展的实施意见》	深入实施产业基础再造工程，补齐基础元器件、基础零部件、基础材料、基础工艺和基础软件等短板，夯实未来产业发展根基；把握全球科技创新和产业发展趋势，重点推进未来制造、未来信息、未来材料、未来能源、未来空间和未来健康六大方向产业发展；同步构筑中试能力，提升精密测量仪器、高端试验设备等供给能力。
2023 年 6 月	工信部等五部门	《制造业可靠性提升实施意见》	实施基础产品可靠性筑基工程，筑牢核心基础零部件、核心基础元器件的可靠性水平；电子行业重点提升精密光学元器件、光通信器件等电子元器件的可靠性水平；机械行业重点提升工业母机用滚珠丝杠、导轨、主轴、转台等关键专用基础零部件和高端轴承、精密齿轮等通用基础零部件的可靠性水平。

2、国内外产业扩张及算力基础设施建设推动精密零部件行业需求持续释放

随着全球半导体产业扩产、算力基础设施建设推进以及产业链国产化替代进程不断深化，精密零部件作为半导体设备、光通信硬件的核心基础环节，下游整机需求持续释放，行业整体市场规模保持稳步增长。根据共研网数据，2025 年全球精密零部件市场规模为 18,217 亿元，2026 年市场规模提升至 18,970 亿元，预计 2032 年市场规模将达到 23,794 亿元，2026 年至 2032 年复合年均增长率为 3.8%。长期来看，全球晶圆厂资本开支扩张、CPO 等新兴光通信技术产业化落地，将持续拉动高端精密零部件采购需求，为行业带来稳定的成长空间。

3、公司业务进入加速成长期，需进一步提升现有产能实力把握市场机遇

经过二十余年发展，公司构建了涵盖机器视觉与光学、精密传感与测试、

运动控制与机器人、软件技术、精密机械设计五大技术领域的成熟研发体系，并形成了“高速、高精、高智、高效”四大共性技术平台，以及覆盖各下游行业产品特性的专用核心技术平台。在精密零部件加工方面，公司配置 700 台套以上超高精度加工设备，多类工序加工精度可达 $\pm 1\mu\text{m}$ 以内；在设备端，核心设备贴装、耦合精度可达 $\pm 50\text{nm}$ ，产品已通过行业头部客户验证并实现量产交付。

近年来，公司半导体及光通信相关业务进入加速成长期。2026 年上半年，公司实现营业收入 14.68 亿元，同比增长 32.71%，半导体及光通信相关业务占比进一步提升。随着 AI 算力建设带动半导体及光模块相关市场快速扩容，下游头部客户对公司精密零部件与设备的采购需求持续增长，通过本次募集资金推进产能扩建，将进一步推动提升公司交付能力，把握市场增长机遇。

（二）本次发行的目的

1、借助资本市场力量，把握行业高景气窗口期，实现公司战略加速落地

近年来，公司持续围绕 3+N 业务战略开展经营活动，将半导体及光通信领域作为“N 类业务”战略发展的核心孵化方向。当前行业正处于 AI 算力驱动下的高景气周期，市场需求快速扩容，竞争格局尚未固化，是公司扩大市场份额、确立行业地位的关键窗口期。本次向特定对象发行股票旨在借助资本市场的直接融资功能，为公司战略落地提供充足的资金保障，使公司能够在行业上升期集中资源投入产能建设，将已有的技术优势和客户基础迅速转化为规模优势和市场优势，并推动公司在半导体及光通信精密制造领域实现从技术领先到规模领先，成为公司业务新一核心增长极，实现战略布局“4+N”的跨越。

2、深化与核心客户的战略合作，提升公司在高端精密制造领域的市场地位

在半导体及光通信领域，下游客户对供应商的产能规模、交付能力、技术水平和资金实力均有较高要求，头部客户在选择核心供应商时，会综合考量供应商的长期发展潜力和持续服务能力，尤其对超高精密零部件加工、净化间清洗、净化间装配等关键生产工艺条件设置严苛准入标准。本次募投项目建设完成后，公司将建设高标准净化生产环境，增强超高精密零部件加工、净化间清洗、净化间装配核心工艺能力。公司半导体及光通信领域产能布局将大幅提升，

业务规划以及生产经营管理的稳定性将持续加强，有利于增强下游核心客户对公司的合作信心，深化公司与头部客户的战略合作关系，在客户持续的产品迭代和产能扩张中获得更多的业务机会。从长期来看，有助于扩大公司业务规模、提高市场份额、提升公司经营效率和盈利能力。

3、优化资本结构，提升资金实力

通过本次向特定对象发行股票募集资金，公司将进一步优化财务结构，降低资产负债率，提高资金实力和抗风险能力。募集资金到位后，公司资金实力将得到增强，提高公司风险应对能力，有助于夯实公司在产业布局、长期发展战略等方面的可持续发展基础，为深化业务布局、实现跨越式发展、巩固行业地位创造良好条件。

三、发行对象及其与本公司的关系

本次发行对象为不超过 35 名（含本数）符合中国证监会规定条件的特定对象，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者、自然人或其他合格投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、理财公司、保险公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

最终发行对象将在本次发行经深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后，由公司董事会在股东会授权范围内根据询价结果，与保荐人（主承销商）协商确定。若发行时法律、法规或规范性文件对发行对象另有规定的，从其规定。

截至本预案公告日，公司尚未确定具体的发行对象，因而无法确定发行对象与公司的关系。具体发行对象与公司之间的关系将在发行询价结束后的相关公告中予以披露。

四、本次发行股票方案概要

（一）发行股票的种类和面值

本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人

民币 1.00 元。

（二）发行方式和发行时间

本次发行采用向特定对象发行股票方式，在经深圳证券交易所审核通过以及获得中国证监会同意注册的文件的有效期限内择机发行。

（三）发行对象及认购方式

本次发行对象为不超过 35 名（含本数）符合中国证监会规定条件的特定对象，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者、自然人或其他合格投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、理财公司、保险公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

最终发行对象将在本次发行经深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后，由公司董事会在股东会授权范围内根据询价结果，与保荐人（主承销商）协商确定。若发行时法律、法规或规范性文件对发行对象另有规定的，从其规定。

所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。

（四）定价基准日、发行价格和定价原则

本次发行的定价基准日为公司本次发行股票的发行期首日。

发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易总量）。

如公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行价格将进行相应调整。调整公式如下：

1、派发现金股利： $P_1 = P_0 - D$

2、送红股或转增股本： $P_1 = P_0 / (1 + N)$

3、两项同时进行： $P_1=(P_0-D)/(1+N)$

其中， P_1 为调整后发行价格， P_0 为调整前发行价格，每股派发现金股利为 D ，每股送红股或转增股本数为 N 。

本次发行的最终发行价格由董事会根据股东会授权，在本次发行经深交所审核通过并经中国证监会同意注册后，按照中国证监会及深交所相关规定，根据询价结果与保荐人（主承销商）协商确定。

（五）发行数量

本次发行股票数量不超过 125,994,739 股（含本数），不超过本次发行前公司总股本的 30%，最终发行数量由公司股东会授权董事会在本次发行取得中国证监会作出予以注册的决定后，根据法律、法规和规范性文件的相关规定及发行时的实际情况，与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的，则本次发行的股票数量上限将进行相应调整。

（六）本次发行的限售期

本次向特定对象发行的股票自本次发行结束之日起 6 个月内不得转让。本次发行结束后，由于公司分配股票股利、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期届满后发行对象减持认购的本次发行的股票须遵守中国证监会、深交所等监管部门的相关规定。若相关法律、法规和规范性文件对发行对象所认购股份限售期及限售期届满后转让股份另有规定的，从其规定。

（七）募集资金总额及用途

本次发行的募集资金总额不超过 75,248.41 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	超高精密度零部件基地建设及相关设备扩产项目	69,729.39	63,248.41
2	补充流动资金	12,000.00	12,000.00

合计	81,729.39	75,248.41
----	-----------	-----------

本次发行募集资金到位之前，公司可根据项目实际进展情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后，以募集资金置换自筹资金。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

（八）本次发行前滚存利润的安排

本次发行完成后，公司发行前滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。

（九）上市地点

本次发行的股票将申请在深圳证券交易所上市交易。

（十）本次发行决议有效期

本次发行决议的有效期为股东会审议通过之日起 12 个月。

五、本次发行是否构成关联交易

截至本预案公告日，本次发行尚未确定具体发行对象，最终是否存在因关联方认购公司本次向特定对象发行股份构成关联交易的情形，将在发行结束后公告的发行情况报告书中披露。

六、本次发行是否导致公司控制权发生变化

截至本预案披露之日，发行人控股股东为新加坡科瑞技术，持有公司 34.89% 的股份；公司实际控制人为潘利明先生，潘利明现任公司董事长，潘利明通过新加坡科瑞技术间接持有公司 24.91% 的股权。

本次发行完成后，新加坡科瑞技术、潘利明先生持有的公司股份比例将有所下降，但预计仍为公司控股股东、实际控制人。因此，本次发行预计不会导致公司控制权发生变化。

七、本次发行是否可能导致公司股份分布不具备上市条件

本次发行完成后，公司社会公众股占总股本的比例仍超过 10%。因此，本次发行不会导致公司股权分布不具备上市条件。

八、本次向特定对象发行的审批程序

（一）本次发行已取得的授权和批准

2026 年 9 月 22 日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票预案的议案》《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》等议案。

（二）本次发行尚需获得的授权、批准和核准

- 1、公司股东会审议通过本次发行的相关议案。
- 2、深交所审核并作出公司是否符合发行条件和信息披露要求的审核意见。
- 3、中国证监会对公司的注册申请作出同意注册的决定。

第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析

一、本次募集资金使用计划

本次发行的募集资金总额不超过 75,248.41 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	超高精密度零部件基地建设及相关设备扩产项目	69,729.39	63,248.41
2	补充流动资金	12,000.00	12,000.00
合计		81,729.39	75,248.41

本次发行募集资金到位之前，公司可根据项目实际进展情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后，以募集资金置换自筹资金。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

二、募集资金投资项目情况介绍

（一）超高精密度零部件基地建设及相关设备扩产项目

1、项目基本情况

本项目系公司顺应半导体设备国产化与光通信产业代际升级趋势，前瞻布局超高精密制造能力的重要举措，通过购置先进的生产设备、检测设备，在深圳扩建面向半导体及光通信等领域的精密零部件与精密设备生产基地，搭建面向半导体超高精度精密零部件与精密设备规模化生产装配的高标准厂房和净化车间。

本项目建成后，将形成精密零部件及规模化装配设备合计年产值 10.53 亿元的生产能力，强化设备与零部件协同配套能力，增强对国内外头部客户的批量订单交付能力。项目将依托公司平台型技术体系优势，深度对接头部客户研发导入与量产配套需求，助力公司深度参与半导体设备国产化进程、把握下一代光互联技术产业化机遇，提升公司在超高精密制造领域的核心竞争力与盈利

能力。

2、项目实施的必要性

（1）深化设备与零部件协同配套能力，把握下游产业迭代机遇

精密零部件下游应用高度分散，不同设备厂商对零部件的结构、材料与性能要求存在显著差异，行业整体呈现高度定制化的业务特征。随着光互联技术持续演进、半导体先进制程持续发展，下游对零部件精度、稳定性及交付一致性的要求持续提升，下游客户对可深度参与前端研发、同时具备设备与零部件协同配套能力的供应商需求日益增强。在此趋势下，仅有单一加工能力的企业难以满足客户对系统级解决方案的需求，设备与零部件的协同开发能力正逐步成为客户筛选供应商的核心标准。面对下游客户对一体化解决方案需求的持续升级，公司亟需进一步强化设备与零部件的协同配套能力，巩固在高端客户供应链体系中的重要地位。

本项目将强化公司在非标定制、协同配套及客户早期研发介入方面的综合服务能力。项目建成后，公司将进一步完善从核心零部件到精密设备的完整供应链条，更好把握光通信及半导体产业迭代带来的业务机会，深化与下游头部客户的战略合作关系，在客户下一代产品迭代周期中持续获得增量订单，夯实公司在精密制造领域的市场竞争优势。

（2）布局超高精密制造能力，把握光通信产业及相关产业代际升级潜力

随着人工智能技术深度普及与规模化应用，全球高性能计算及高速数据传输领域需求呈现爆发式增长。AI 算力集群的大规模部署推动数据中心互联架构加速向超高速率方向迭代，光通信产品从 400G 向 800G、1.6T 乃至更高速率持续升级，传统可插拔光模块架构在高速率场景下面临信号衰减、功耗攀升等系统性瓶颈，共封装光学 CPO 技术已成为行业未来演进方向，配套的精密金属零部件及核心工艺设备需求随之迎来快速增长。行业技术迭代对配套零部件、核心设备的加工精度、稳定性、一致性提出了更高要求，超高精密零部件和设备成为行业产业化的核心关键。

公司在光通信领域已有产品布局与客户基础，产品涵盖主流高精密结构件，已在光模块核心工艺段获得海外头部客户验证与认可。同时，公司光器件耦合

设备、光模块芯片共晶贴片设备等设备核心技术达到行业领先水平。面对光通信行业技术路线升级带来的增量市场空间，公司现有超高精密零部件与设备产能难以充分承接下游客户持续增长的采购需求。

本项目立足行业高端化发展趋势，聚焦光通信领域超高精密零部件与精密设备两大领域，引进高精度生产及检测设备，搭建超高精密产业化生产体系，实现产品从常规精度向超高精度的迭代升级。本项目建成后，公司将抢抓 CPO 技术产业化红利、扩充超高精密产品产能，助力公司卡位光通信高端核心赛道，构建差异化核心竞争优势，巩固在全球光通信精密制造领域的市场地位。

（3）顺应半导体设备国产化趋势，加速构建核心配套能力

我国集成电路产业快速发展，下游晶圆制造、先进封装测试产线建设持续推进，对半导体设备及其核心精密零部件的国产化配套需求持续攀升。半导体设备零部件作为整机装备实现稳定运行的关键基础，是国内半导体产业链补短板、强链条的重要环节，行业整体市场规模保持高速增长，市场发展空间广阔。其中机械类结构件、工艺件等零部件品类市场需求旺盛，国产替代空间充足，为具备高端精密制造实力的本土企业带来广阔的增量发展机遇。

公司在半导体精密零部件与设备领域已形成较好的技术与客户基础。在半导体设备领域，公司已开发晶圆自动测试设备等产品，并实现小批量量产，相关技术获得国内头部半导体客户认可。面对半导体设备国产化提速的确定性趋势，公司需进一步提升核心零部件的自主配套能力。

本项目将建设专门面向半导体领域的高标准精密制造基地，提升公司在半导体精密零部件及半导体精密设备领域的产能规模与工艺水平，进一步增强公司对国内半导体设备客户的一体化配套能力。项目建设将助力公司深度参与半导体设备国产化进程，在国产供应链体系中占据更为重要的位置，共享国产替代带来的长期成长红利。

3、项目实施的可行性

（1）平台型核心技术体系为项目切入新兴领域提供技术基础

公司自 2001 年成立以来，始终专注于非标自动化技术在先进制造领域的跨行业应用，是国内少数能够同时服务移动终端、新能源、硬盘、汽车智驾、医

疗健康等多个行业的平台型自动化解决方案供应商。经过二十余年发展，公司构建了涵盖机器视觉与光学、精密传感与测试、运动控制与机器人、软件技术、精密机械设计五大技术领域的成熟研发体系，并形成了“高速、高精、高智、高效”四大共性技术平台，以及覆盖各下游行业产品特性的专用核心技术平台。这一平台型架构使得公司能够将不同行业积累的精密装配、在线检测、运动控制等成熟工艺快速复用至新兴领域，显著降低技术迁移成本和导入周期。

在半导体及光通信设备领域，公司已经成功将过去服务于移动终端摄像头模组检测、硬盘磁头装配等高精度场景的技术能力，平移至高精度贴装及对贴装配设备、芯片共晶贴片、光耦合设备等核心工序中，并获得海外头部客户的验证与认可。平台型技术架构不仅使公司具备快速响应新兴行业定制化需求的能力，也为本次募投项目涉及的半导体及光通信精密零部件与设备扩产提供了成熟的技术底座和工程化经验支撑，确保新增产能能够迅速转化为满足行业严苛要求的高品质产品。

（2）超高精度加工能力为研发定制与量产交付提供双重保障

半导体及光通信器件的小型化、高集成度发展趋势，对精密零部件的加工精度和设备的系统级精度提出了持续升级的要求，微米乃至亚微米级的制造能力已成为行业竞争的关键壁垒。公司拥有行业领先的超高精度加工体系，配备高精度精密零部件加工设备 700 余台套，具备车、铣、磨、CNC、电火花、线切割等全工序加工能力，其中精密 CNC、线切割、电火花、镗磨、平面磨、光学磨等关键工种的加工精度可达 $\pm 1\mu\text{m}$ 以内，零部件洁净度可达 RA0.02。在系统集成层面，公司自研的三轴高精平台已实现规模化量产，重复定位精度达 $\pm 50\text{nm}$ ，自研六轴平台最小步进精度小于 30nm，设备系统贴装精度控制在 $\pm 0.5\mu\text{m}$ 以内，晶圆测试温控范围在 $\pm 0.1^\circ\text{C}$ 以内，能够充分匹配半导体及光模块器件组装对精度和稳定性的严苛指标。

本项目所涉及的高精度耦合设备、晶圆测试设备及各类精密金属结构件，均对加工精度和装配一致性有较高要求。公司已有的超高精度加工能力和精密运动平台研发制造经验，能够为项目产品的研发定制阶段提供快速试制和迭代验证条件。在进入批量化生产阶段后，公司上述技术可保障产品良率与性能一致性，满足头部客户对供应链稳定性和交付质量的长期需求。

（3）深度参与客户早期研发，绑定下一代技术路线以巩固竞争优势

公司长期坚持与各行业头部客户在新产品研发设计阶段即开展深度合作，在客户产品定义和工艺方案定型之前即介入预研，深入分析客户产品的生产工艺、技术参数及质量管控要点，共同确定自动化设备的功能架构与实现方案。这一模式使公司能够精准把握客户下一代产品对设备精度和工艺参数的升级需求，提前进行技术布局，从而在新一代产线设备采购周期中占据先发优势。在移动终端和新能源领域，公司已通过该模式与多家全球领先品牌建立了长期稳定的合作关系，成为其核心设备供应商。

在半导体及光通信领域，公司已成功为国内外多家头部客户提供覆盖光器件耦合、芯片贴装、AOI 芯片检测、光纤打磨等核心工序的工艺设备，并已获得海外头部客户的验证与认可。当前光模块正经历从 800G 向 1.6T 乃至 3.2T 的代际升级，工艺路线和精度要求持续演进，公司依托已有的早期参与机制和联合研发能力，能够在客户下一代产品量产前即锁定设备技术参数和供应份额。本次募投项目将充分运用这一先发合作模式，深度嵌入半导体及光通信行业头部企业的技术迭代路径，推动高精密自动化设备与零部件的同步升级，进一步巩固并扩大公司在行业内的市场份额与竞争壁垒。

4、项目投资概算

本项目投资总额为 69,729.39 万元，募集资金拟投入金额为 63,248.41 万元。

5、项目实施主体及实施地点

本项目由科瑞技术及其全资子公司科瑞科技负责实施，实施地点为广东省深圳市。

6、项目经济效益

本项目完全达产后，公司预计能实现年均销售收入 105,310.00 万元，年均净利润 11,879.62 万元，综合毛利率为 31.80%，净利率为 11.28%。本项目税后内部收益率为 13.75%，税后静态投资回收期为 8.08 年。

（二）补充流动资金

1、项目基本情况

根据公司经营发展规划，公司拟使用募集资金 12,000.00 万元用于补充流动资金，有助于缓解公司快速发展过程中对资金的需求压力，保证公司可持续发展。

2、项目实施的必要性和合理性分析

（1）提供营运资金支持，抓住快速发展机遇

未来随着公司业务规模与营收规模的提升，应收账款及存货等经营性流动资产规模也将同步扩大，对流动资金形成一定占用。因此，公司通过本次发行募集资金部分用于补充流动资金，有利于保障公司在业务规模扩大过程中的日常营运资金需求，帮助公司快速抓住行业发展机遇，提升公司市场竞争力。

（2）优化公司财务结构，增强公司抗风险能力

本次发行募集资金部分用于补充流动资金，有助于公司优化财务结构，增强公司资本实力，从而降低公司财务风险，提高公司的偿债能力和抗风险能力，保障公司持续、稳定、健康发展。

第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

一、本次发行后公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务收入结构的变动情况

（一）对公司业务及资产的影响

本次发行所募集的资金，主要用于推进公司主营业务相关的项目建设，将有利于本公司主营业务的发展，本公司的行业地位、业务规模都有望得到进一步的提升和巩固，核心竞争力将进一步增强，能够保证公司未来持续发展，提升公司的盈利能力。本次发行后，公司的主营业务范围保持不变，不会导致公司业务和资产的整合。

本次发行完成后，公司总资产、净资产规模将进一步增加，财务结构更趋合理，有利于增强公司资产结构的稳定性和抗风险能力，对公司长期可持续发展产生积极作用和影响。

（二）对公司章程的影响

本次发行完成后，公司的股本总额将增加，股东结构将发生一定变化。公司将根据发行的实际情况对《公司章程》中与股本相应的条款进行相应修改，并办理工商变更登记。除此之外，公司暂无其他因本次发行而修改或调整公司章程的计划。

（三）对股东结构的影响

本次发行完成后，公司的股本总额将增加，股东结构将发生一定变化，公司原股东的持股比例也将相应发生变化。本次发行完成后，新加坡科瑞技术、潘利明先生持有的公司股份比例将有所下降，但预计仍为公司控股股东、实际控制人。因此，本次发行预计不会导致公司控制权发生变化。

（四）对高管人员结构的影响

公司暂无因本次发行而拟对公司高管人员进行调整的计划。若公司未来拟调整高管人员结构，将根据有关规定，履行必要的法律程序和信息披露义务。

（五）对业务收入结构的影响

本次募集资金投资项目在原业务范围的基础上，紧紧围绕公司主营业务展开，发行完成后，公司主营业务保持不变，业务收入结构亦不会发生重大变动，长期来看，将有利于提升公司的综合实力和市场竞争力，为公司的持续成长提供坚实的支撑。

二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流的变动情况

本次发行将对公司整体财务状况带来积极影响。本次发行完成后，公司财务风险将有效降低、持续经营能力将进一步提高，核心竞争实力将得到增强。具体影响如下：

（一）对公司财务状况的影响

本次发行完成后，公司总资产、净资产规模将进一步增加，从而提升公司的自有资金实力和偿债能力，财务结构更趋合理，有利于增强公司资产结构的稳定性和抗风险能力。

（二）对公司盈利能力的影响

本次发行完成后，公司总资产、净资产规模将进一步增加，虽然募集资金投资项目具有良好的经济效益，但由于募投项目的实施存在建设周期，募集资金使用效益短期内难以完全释放，因此短期内可能会导致净资产收益率、每股收益等财务指标出现一定程度的摊薄。但从长期来看，本次募投项目具有良好的市场前景和经济效益，随着募投项目的逐步实施和效益显现，公司的综合实力和市场竞争力将显著提升，有助于提升公司的盈利能力和经营状况。

（三）对公司现金流量的影响

本次发行完成后，公司筹资活动现金流入将进一步增加。随着募投项目的逐步实施和效益显现，有助于增加未来的经营活动现金流入，从而进一步改善公司的现金流状况。

三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况

本次发行前，公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立经营，不受控股股东及其关联人的影响。本次发行完成后，公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系均不会发生变化，也不会因此新增关联交易或形成新的同业竞争。

四、本次发行完成后，公司不存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，不存在公司为控股股东及其关联人提供担保的情形

公司的资金使用和对外担保严格按照法律法规和《公司章程》的有关规定履行相应授权审批程序并及时履行信息披露义务，不存在被控股股东及其关联人违规占用资金、资产或违规为其提供担保的情形。本次发行完成后，公司不会因本次发行产生被控股股东及其关联人违规占用公司资金、资产或为其提供担保的情形。

五、公司负债结构合理，不存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，不存在负债比例过低、财务成本不合理的情况

本次发行完成后，公司总资产、净资产规模将进一步增加，从而提升公司的自有资金实力和偿债能力，财务结构更趋合理；公司不存在负债比例过低、财务成本不合理的情况。

六、本次股票发行相关的风险说明

（一）经营风险

1、市场竞争风险

公司产品主要包括自动化设备、自动化设备配件和精密零部件。国外厂商凭借其技术优势在行业竞争中处于优势地位，国内厂商由于技术积累相对薄弱，普遍面临较为严峻的市场竞争形势。由于我国智能装备制造行业前景广阔，新进入者投资意愿较强，公司主要竞争对手纷纷开展资本运作壮大实力。如果公司不能继续提升技术研发和服务水平、加强产品质量控制和成本管理，未来由

于市场竞争加剧将可能导致公司产品的市场价格出现下降，对公司未来的盈利能力产生不利影响。

2、下游应用行业发展节奏和规模不达预期的风险

非标自动化设备公司的下游应用领域广泛，各行业的发展节奏与规模扩张存在显著的不确定性，在以下方面存在收入规模风险：一是技术迭代不及预期，如固态电池、1.6T 光模块等新技术的产业化进程若推迟，将直接导致设备采购需求延后或减少；二是终端市场需求波动，如智能手机进入存量竞争、新能源车补贴退坡或储能项目并网不及预期，可能引发下游客户缩减资本开支、推迟或取消扩产计划；三是产能阶段性过剩，部分行业在快速扩张后可能出现结构性产能过剩，导致新设备订单骤降，存量产线升级需求也随之放缓；四是政策与外部环境变化，半导体国产化进程受地缘政治影响存在不确定性，AI 算力基建的行业热度、财政支持力度也可能波动。上述风险一旦发生，将导致已投入的研发成本无法回收、在手订单延期或取消、应收账款周转恶化，进而对业绩产生较大冲击。

（二）发行风险

1、审批风险

本次向特定对象发行股票方案尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施。公司能否取得上述批准与注册，以及最终取得批准与注册的时间存在不确定性。

2、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险

本次向特定对象发行的募集资金到位后，公司的总股本和净资产规模将有所增加，而募投项目效益的产生需要一定时间周期，在募投项目产生效益之前，公司的利润实现和股东回报仍主要通过现有业务实现。因此，本次向特定对象发行可能会导致公司的即期回报在短期内有所摊薄。此外，若公司本次向特定对象发行募集资金投资项目未能实现预期效益，进而导致公司未来的业务规模和利润水平未能产生相应增长，则公司的每股收益、净资产收益率等财务指标将出现一定幅度的下降。特此提醒投资者关注本次向特定对象发行股票可能摊薄即期回报的风险。

（三）与募集资金运用相关的风险

1、募集资金投资项目实施风险

公司本次募集资金投资项目的可行性以及预计经济效益是基于当前的宏观经济环境、产业政策、市场供求关系、行业技术水平、市场价格等现有情况基础上进行的合理预测，但由于募集资金投资项目的实施存在一定周期，若在实施过程中上述因素发生重大不利变化，则公司本次募集资金投资项目的实施效果将受到不利影响，可能导致项目实施进度推迟或项目建成后无法实现预期效益。

2、募集资金投资项目达产后新增产能无法消化的风险

公司本次募集资金投资项目为超高精密度零部件基地建设及相关设备扩产项目和补充流动资金，项目达产后将进一步扩张产能。若公司因经济环境或产业政策导致主要产品市场空间减小、后续公司产品开发无法满足市场需求、行业竞争加剧导致客户开拓以及订单获取不及预期，无法消化募集资金投资项目新增产能，将导致项目无法实现预期收益，从而对公司未来经营业绩产生不利影响。

3、募投项目新增折旧和摊销对公司经营业绩带来的风险

本次募集资金投资项目实施后，公司固定资产规模将进一步扩大，并增加相应的折旧与摊销。募投项目投产后新增的折旧摊销对公司未来年度利润有一定影响，由于项目从开始建设到达产、产生效益需要一段时间，如果短期内公司不能快速消化项目产能，实现预计的规模效益，新增折旧及摊销费用短期内将增加公司的整体运营成本，对公司的盈利水平带来一定的影响，存在未来经营业绩下降的风险。

第四节 公司利润分配政策及执行情况

一、公司利润分配政策

根据《公司法》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等相关制度的规定，结合公司的实际情况，公司制定了以下利润分配政策：

“（一）利润分配原则：公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，应保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定；

（二）利润分配方式：公司利润分配可采取现金、股票、现金股票相结合或者法律许可的其他方式；在有条件的情况下，公司可以进行中期现金利润分配；

（三）利润分配顺序：公司优先选择现金分红的利润分配方式，如不符合现金分红条件，再选择股票股利的利润分配方式。

（四）现金分红的条件及最低比例：当公司当年可供分配利润为正数，同时满足公司正常生产经营的资金需求情况下，公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 10%；

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力、是否有重大资金支出安排以及投资者回报等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，按照前款第 3 项规定处理。

（五）分配股票股利的条件及最低比例：当公司当年可供分配利润为正数时，公司可以采用股票股利方式进行利润分配；每次分配股票股利时，每 10 股股票分得的股票股利不少于 1 股；采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素；

（六）利润分配需履行的决策程序：进行利润分配时，公司董事会应当先制定分配预案，董事会在制定利润分配方案时应充分考虑独立董事、公众投资者的意见；公司董事会审议通过的公司利润分配方案，应当提交公司股东会进行审议；

公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。

独立董事认为现金分红方案可能损害公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议公告中披露独立董事的意见及未采纳或者未完全采纳的具体理由。

股东会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

（七）公司召开年度股东会审议年度利润分配方案时，可审议批准下一年中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等。年度股东会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于公司股东的净利润。董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。

公司应当严格执行公司章程确定的现金分红政策以及股东会审议批准的现金分红方案。确有必要对公司章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足公司章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

（八）公司当年盈利但未提出现金利润分配预案，董事会应当在定期报告中披露未进行现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途；

（九）公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环境发生变化，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；有关调整利润分配政策的议案由董事会制定；调整利润分配政策的议案经董事会审议后提交股东会批准，公司应当安排通过证券交易所交易系统、互联网投票系统等网络投票方式为社会公众股东参加股东会提供便利；

（十）公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说明：

- 1、是否符合公司章程的规定或者股东会决议的要求；
- 2、分红标准和比例是否明确和清晰；
- 3、相关的决策程序和机制是否完备；
- 4、公司未进行现金分红的，应当披露具体原因，以及下一步为增强投资者回报水平拟采取的举措等；
- 5、中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。

对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。

（十一）公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围；

（十二）股东违规占有公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

公司现金股利政策目标为剩余股利政策，保障公司持续发展并兼顾股东合理回报。

当公司出现如下情形之一，公司可以不进行利润分配：（1）最近一年审计报告为非无保留意见或带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见；

（2）最近一年年末公司资产负债率高于 70%；（3）经营性现金流量净额为负值。”

二、公司最近三年的利润分配情况

（一）公司最近三年利润分配

公司于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案》，以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的股份后的 410,376,428 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.72 元（含税），共计派发现金红利人民币 70,584,745.62 元。

公司于 2025 年 5 月 30 日召开 2024 年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的股份后的 417,649,024 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.70 元（含税），共计派发现金红利人民币 71,000,334.08 元。

公司于 2026 年 5 月 15 日召开 2025 年度股东会，审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》，以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的股份后的 419,831,824 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），共计派发现金红利人民币 104,957,956.00 元。

上述利润分配方案已实施完毕。公司最近三年利润分配情况符合《公司章程》的规定。

（二）公司最近三年未分配利润的使用情况

最近三年内公司剩余的未分配利润主要用于补充公司的营运资金、满足新增固定资产投资对资金的需求等，支持公司正常生产经营。

三、未来三年股东分红回报计划（2026 年-2028 年）

为进一步规划利润分配及现金分红有关事项，进一步细化《深圳科瑞技术股份有限公司章程》对利润分配事项的决策程序和机制，积极回报股东，引导股东树立长期投资和理性投资理念，公司根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的要求，结合公司的实际情况，制定了《深圳科瑞技术股份有限公司未来三年股东回报规划（2026 年-2028 年）》并已对外披露，具体内容请查询相关信息披露文件。

第五节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项

一、董事会关于除本次发行外未来十二个月内是否有其他股权融资计划的声明

除本次发行外，在未来十二个月内，公司董事会将根据公司资本结构、业务发展情况，并考虑公司的融资需求以及资本市场发展情况确定是否安排其他股权融资计划。若未来公司根据业务发展需要及资产负债状况安排股权融资，将按照相关法律法规履行审议程序和信息披露义务。

二、本次发行对摊薄即期回报的影响及填补回报的具体措施

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的要求，为保障中小投资者知情权、维护中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下：

（一）本次发行对公司主要财务指标的影响

本次发行完成后，公司总股本和净资产规模将有所增加，而募集资金的使用和产生效益需要一定的周期。在公司总股本和净资产均增加的情况下，如果公司利润暂未获得相应幅度的增长，本次发行完成后公司即期回报将存在被摊薄的风险。此外，一旦前述分析的假设条件或公司经营情况发生重大变化，不能排除本次发行导致即期回报被摊薄情况发生变化的可能性。具体计算分析过程如下：

1、财务指标计算主要假设和说明

（1）假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况及公司经营环境等方面没有发生重大变化；

（2）假设公司于 2027 年 3 月完成本次发行（该完成时间仅用于计算本次

发行对即期回报的影响，不对实际完成时间构成承诺，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。最终以中国证监会实际通过本次发行注册完成时间为准）；

（3）假设发行股份数量为 20,999,123 股，占本次发行前公司股份总数的 5%。本次发行的股份数量和发行完成时间仅为估计，最终以经中国证监会予以注册发行的股份数量和实际发行完成时间为准；

（4）公司 2026 年 1-6 月归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为 16,122.70 万元和 12,070.25 万元，假设公司 2026 年度归属于母公司所有者的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润基于 2026 年 1-6 月数据年化计算、2027 年分别按照-10%、0%、10%的业绩增幅分别测算（上述增长率不代表公司对未来利润的盈利预测，仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要指标的影响，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任）；

（5）不考虑本次发行对公司其他生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响；

（6）假设除本次发行外，公司不会实施其他会对公司总股本发生影响或潜在影响的行为；

（7）在预测公司本次发行后净资产时，未考虑除募集资金、净利润之外的其他因素对净资产的影响；未考虑公司公积金转增股本、分红等其他对股份数有影响的因素；

（8）上述假设仅为测试本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对 2026 年度及 2027 年度经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测，投资者不应据此进行投资决策；

（9）指标根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）的有关规定进行计算。

2、对主要财务指标的影响

基于上述假设，本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响对比如

下:

项目	2025 年度/2025 年 12 月 31 日	2026 年度/2026 年 12 月 31 日	2027 年度/2027 年 12 月 31 日	
			本次发行前	本次发行后
总股本（股）	419,982,466.00	419,982,466.00	419,982,466.00	440,981,589
假设 1：公司 2027 年度归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润与 2026 年度持平				
归属于母公司股东的净利润（万元）	27,308.42	32,245.40	32,245.40	32,245.40
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润（万元）	17,172.08	24,140.51	24,140.51	24,140.51
基本每股收益（元/股）	0.65	0.77	0.77	0.74
稀释每股收益（元/股）	0.65	0.77	0.77	0.74
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）	0.41	0.57	0.57	0.55
扣除非经常性损益后稀释每股收益（元/股）	0.41	0.57	0.57	0.55
假设 2：公司 2027 年度归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润较 2026 年度增长 10%				
归属于母公司股东的净利润（万元）	27,308.42	32,245.40	35,469.94	35,469.94
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润（万元）	17,172.08	24,140.51	26,554.56	26,554.56
基本每股收益（元/股）	0.65	0.77	0.84	0.81
稀释每股收益（元/股）	0.65	0.77	0.84	0.81
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）	0.41	0.57	0.63	0.61
扣除非经常性损益后稀释每股收益（元/股）	0.41	0.57	0.63	0.61
假设 3：公司 2027 年度归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润较 2026 年度减少 10%				
归属于母公司股东的净利润（万元）	27,308.42	32,245.40	29,020.86	29,020.86
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润（万元）	17,172.08	24,140.51	21,726.45	21,726.45
基本每股收益（元/股）	0.65	0.77	0.69	0.67
稀释每股收益（元/股）	0.65	0.77	0.69	0.67
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）	0.41	0.57	0.52	0.50
扣除非经常性损益后稀释每股收益（元/股）	0.41	0.57	0.52	0.50

（二）本次发行股票摊薄即期回报的风险提示

本次发行完成后，公司总股本和净资产规模将有所增加，而募集资金的使用和产生效益需要一定的周期。在公司总股本和净资产均增加的情况下，如果公司利润暂未获得相应幅度的增长，本次发行完成后公司即期回报将存在被摊薄的风险。此外，一旦前述分析的假设条件或公司经营情况发生重大变化，不能排除本次发行导致即期回报被摊薄情况发生变化的可能性。

特别提醒投资者理性投资，关注本次发行可能摊薄即期回报的风险。

（三）本次发行的必要性与可行性

本次发行的必要性与可行性请参见本预案之“第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”之“二、募集资金投资项目情况介绍”。

（四）本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系以及公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

1、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系

公司本次募投项目为超高精密度零部件基地建设及相关设备扩产项目及补充流动资金，募集资金投向围绕现有主营业务展开，系公司为顺应产业发展趋势、响应下游客户日益扩张的产品需求而做出的重要布局，有助于扩大业务规模、巩固市场地位，提升公司核心竞争力。公司正常生产经营对流动资金的要求较高，随着业务规模、营业收入的持续增长，公司营运资金的需求规模也相应提高，存在一定的流动资金缺口。本次补充流动资金能够部分满足未来公司业务持续发展产生的营运资金缺口需求。

2、公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

公司长期以来在主营业务上的研发与经营活动为募集资金投资项目的实施积累了人力资源、技术资源和市场资源：

人员方面，公司十分注重对人才培养，在公司成长过程中，积累并培养了一批优秀的技术研发、生产、销售和管理人才。经过多年发展，公司已拥有一支素质高、能力强、结构合理的人才队伍，并对公司核心人员实施了股权激励。由于公司从事智能装备制造业的研发生产销售，公司拥有大量的掌握

机械、电子、控制、工业软件等跨领域多学科知识的研发技术人才，同时也拥有大量能够深入了解客户需求、生产工艺、产品特征，具备项目实施经验和沟通能力的复合型项目管理人才。公司拥有的大量研发技术人才和项目管理人才充分保证了募投项目的人员需求。

技术方面，经过多年自动化设备领域的研发、设计及制造经验，公司已积累了机器视觉与光学、精密传感与测试、运动控制与机器人、软件技术、精密机械设计五大领域的相关技术，形成了“高速、高精、高智、高效”四大共性技术平台，以及与下游行业各类产品相关的专用核心技术平台，能够满足多种复杂自动化系统集成的技术要求。

市场方面，凭借优秀的产品技术、可靠的产品质量、合理的产品价格和周到的产品服务，公司已经赢得了各行业客户的普遍认可，与多家全球知名的移动终端、新能源、半导体及光模块、硬盘、汽车智驾、医疗健康等产品制造商建立了良好的合作关系，公司已在行业内建立了较高的品牌知名度和良好的品牌效应。这种品牌优势将很好地服务于公司的发展战略，为公司长期持续稳定发展奠定良好基础。

综上，公司在人员、技术、市场等方面已经具备了实施募集资金投资项目的各项条件，募集资金到位后，公司将按照计划推进募集资金投资项目的建设。

（五）公司填补本次发行摊薄即期回报采取的主要措施

为保证此次募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄的风险，提高未来的回报能力，公司拟采取以下措施：

1、全面提升公司管理水平，提升经营效率和盈利能力

公司将发挥科研优势，提高生产效率。不断提升经营管理水平，加强销售回款的催收力度，提高资产运营效率。同时，公司将完善并强化投资决策程序，合理运用各种融资工具和渠道，控制资金成本，节省公司的各项费用支出，全面有效地提升经营效率和盈利能力。

2、加快募投项目投资进度，争取早日实现预期效益

本次发行募集资金到位前，为尽快实现募集资金投资项目效益，公司将积极调配资源，争取提前完成募集资金投资项目的前期准备工作并以自有资金开展前期建设；本次发行募集资金到位后，公司将加快推进募集资金投资项目建设，争取早日达产并实现预期效益，增加以后年度的股东回报，弥补本次发行导致的即期回报摊薄的影响。

3、加强对募集资金监管，保证募集资金合理合法使用

根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定并结合《公司章程》和实际情况，公司制定了相关的募集资金管理办法，对募集资金的专户存储、使用、管理和监管进行了明确的规定。本次发行募集资金到位后，公司董事会将持续监督公司对募集资金进行专项存储，保障募集资金用于指定项目，定期对募集资金进行内部审计，积极配合保荐人和监管银行对募集资金使用的检查和监督，合理防范募集资金的使用风险。

4、保证持续稳定的利润分配政策，加强投资者回报机制

为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，并形成稳定的回报预期，根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》等相关规定，公司制定了《深圳科瑞技术股份有限公司未来三年股东回报规划（2026年-2028年）》，进一步明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例和股票股利分配条件等，完善了公司利润分配的决策机制和利润分配政策的调整原则。公司将严格执行公司分红政策，强化投资者回报机制，确保公司股东特别是中小股东的利益得到保护。

（六）公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺

为确保公司填补回报措施能够得到切实履行，公司全体董事、高级管理人员作出如下承诺：

“1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不得采用其他方式损害公司利益；

- 2、对自身的职务消费行为进行约束；
- 3、不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
- 4、董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
- 5、未来拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
- 6、自本承诺出具之日起至公司本次发行实施完毕前，若证券监督管理部门作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足该等规定时，本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺；
- 7、本人切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。”

（七）公司控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺

为确保公司填补回报措施能够得到切实履行，公司控股股东、实际控制人作出如下承诺：

- “1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；
- 2、自本承诺出具之日起至公司本次发行实施完毕前，若证券监督管理部门作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足该等规定时，本公司/本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺；
- 3、切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本公司/本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺。若本公司/本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本公司/本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。”

（本页无正文，为《深圳科瑞技术股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票预案》之签章页）

深圳科瑞技术股份有限公司董事会

2026 年 9 月 23 日